

200・300mmウェーハ対応ソルダーバンプ形成用N<sub>2</sub>リフローシステム  
Nitrogen Reflow Oven for the Solder bump forming of 200 and 300 mm Wafer.

**NRV-103V6W/LU**

## **N<sub>2</sub> REFLOW SYSTEM FOR WAFER BUMP FORMING**

**ボール搭載後、または印刷バンプ後のリフローに適応します。**

It is the N<sub>2</sub> Reflow furnace for the solder bump forming after the ball attaching or the solder printing!

**メッキバンププロセス後のウェットバック装置としても対応可能です。**

It is the wet back furnace for the bump forming after the solder plating process!



200・300 mm 印刷バンプ対応N<sub>2</sub>リフロー装置 (L=4000 mm)  
N<sub>2</sub> Reflow oven for solder printing bump of 200 and 300 mm wafer.

150・200mm 印刷バンプ対応N<sub>2</sub>リフロー (L=3150 mm)  
N<sub>2</sub> Reflow oven for 150 and 200 mm wafer.

### **主な特長**

1. 加熱方式は、ホットプレートと上部遠赤外線ヒータの併用。  
ホットプレートは、ウェーハの反りに適応したピン立て加熱。
2. プリヒートゾーンのホットプレートピンは、当社独自の  
昇降式ピンを採用し、温度プロファイルの2段階加熱を可能  
にしております。(PAT.P)
3. 強制対流加熱とは異なり、炉内のクリーン度に優れ、更に  
低酸素濃度にも容易に対応できます。(100ppm以下)
4. 炉内搬送は、当社独自のウオーキングビーム (PAT.) による  
タクト送り。
5. ウェーハのローディング、アンローディングには、3軸  
クリーンロボットを2基搭載。クリーン度に優れた高精度  
な搬送が可能です。
6. オプションにてフラックスディスペンサーやスピスコータ  
も内蔵できます。

### **Major features**

1. The heating system employs the combination of the hot plate and the upper  
far-infrared heater. The hot plate employs the pins-supported heating  
mechanism to accept warped wafer.
2. Our unique elevating pin design is used for hot plate pins at the preheat  
zone, allowing two-staged heating about the temperature profile. (PAT.P)
3. This combination heating, different from the forced convection heating,  
improves the cleanliness in the furnace and can keep lower oxygen  
density easily (100ppm $\geq$ ).
4. In the furnace, wafers are transferred by our unique walking beams  
transfer system using tact sending. (PAT.)
5. Wafers are loaded and unloaded by two three-axis clean robots, allowing  
highly clean and accurate wafer transfer.
6. Optional components such as flux dispenser and spin coater can be built  
in the reflow oven.

**YAMATO WORKS CO.,LTD.**